

プレスリリース

報道関係者各位

HPC システムズ株式会社

代表取締役 小野 鉄平

(コード番号 : 6597 東証グロース)

問合せ先 取締役管理部長 下川 健司

(電話番号 : 03-5446-5530)

HPC システムズ、世界6地域に適合した産業用コンピュータを発売開始 ～性能と拡張性を両立し、画像検査装置メーカーのグローバル展開を支援～

HPC システムズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 小野 鉄平、以下 HPC システムズ）は、半導体検査装置をはじめとする画像検査装置向けの産業用コンピュータ「IPC-R670EM-SC-REG シリーズ」を、2026 年 8 月 6 日に発売します。個別開発と規格適合に約 9～12 か月を要していた産業用コンピュータを、6 地域の規格に適合した標準品として提供することで、装置開発の期間とコストを画期的に削減します。



- 本製品は、PCIe 5.0 対応スロット 2 基を備え、フレームグラバードと GPU がそれぞれ独立した帯域を利用できる拡張性と、第 14 世代インテル® Core™ プロセッサによる演算性能を両立した、半導体検査装置をはじめとする画像検査装置向けの産業用コンピュータです。
- 本製品は、米国/カナダ (UL) ・米国 (FCC) ・欧州 (CE) に加え、中国 (CCC) ・台湾 (BSMI) ・韓国 (KC) を含む 6 地域の安全・EMC 規格に適合しています。3 モデル (インテル® Core™ i7 / i5 / i3) からの選択に加え、メモリ・ストレージの構成も、規格適合を維持したまま変更も可能です。また、拡張カードの選択・搭載は、従来どおり装置メーカーが行えます。
- 従来、コンピュータの新規開発と規格適合には約 9～12 か月の期間を要していました。しかし、本製品の導入により、標準品の調達リードタイムのみで、規格適合済みコンピュータを装置に組み込むことが可能となります。開発期間の画期的な短縮により、装置メーカーの製品開発効率を最大化します。

【開発の背景】

画像検査装置は、高解像度画像をリアルタイムに処理するため、高い演算性能と、フレームグラバードや GPU といったフルサイズ拡張カードを複数搭載できる拡張性を必要とします。近年、当社にご相談いただく案件でも、フレームグラバードに加えて GPU を搭載する構成が増えています。検査工程に AI による判定を組み込む装置の広がり、その背景にあると考えています。これらは消費電力や発熱が大きく、安全性評価の重要性もますます高くなっています。

一方、これらの装置をグローバル市場へ展開するには、米国/カナダ（UL）・米国（FCC）・欧州（CE）・中国（CCC）・台湾（BSMI）・韓国（KC）の規格適合が求められます。以前は「装置全体で認証を取るの、PC は未認証でもよい」というケースが多くありました。しかし現在は、認証機関から組み込む部品について安全性のエビデンスを求められるケースが増えています。そのため、PC 自体が規格適合済みであることが望まれるようになっていきます。しかし、性能と拡張性を高めるほど、消費電力・発熱の増加や構成の複雑化により、規格適合のハードルは上がります。

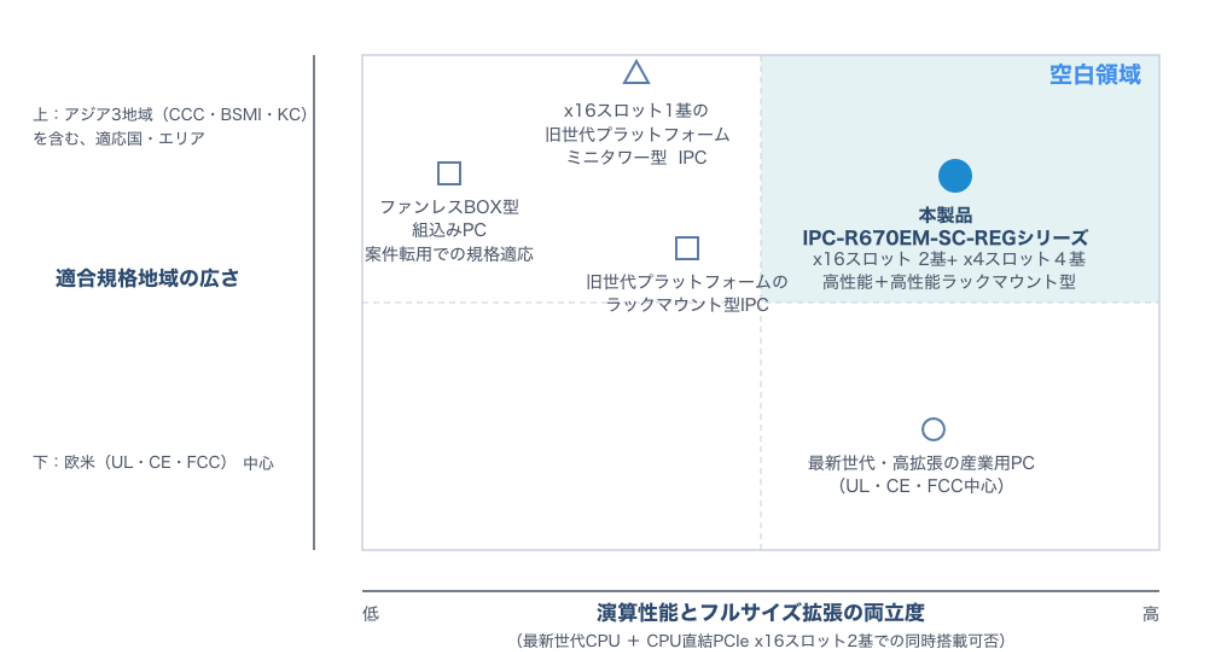
また、この分野は装置ごとに要件が異なる多品種少量市場であり、一機種あたりの数量が読みにくく、6 地域分の規格適合に要する費用を標準品として回収する見通しが立ちにくいことから、装置固有の要件を満たすコンピュータは個別開発に委ねられてきました。

さらに、装置メーカーの競争激化から、開発サイクルの短縮が求められるようになり、コンピュータの安全評価を一から行う時間やコストを削減したいというニーズが高まっています。

こうした装置メーカーの課題に対応するため、HPC システムズは性能と拡張性を両立する海外規格適合済み産業用コンピュータを開発いたしました。

産業用コンピュータの製品カテゴリ別ポジション

演算性能・フルサイズ拡張の両立度 × 適合規格地域の広さ



【本製品導入効果】

- 装置認証における前提条件の確保
装置全体の認証取得において、内部コンピュータが 6 地域の規格に適合済みである状態から着手できる
- 規格適合に伴う試験・認証の費用の負担なし
6 地域分の規格適合を標準品として調達でき、規格適合に伴う試験・認証の費用も、専用機の開発費も発生しない
- 開発期間を、調達期間へ
当社の受託実績において約 9～12 か月を要した開発・規格適合のプロセスを経ずに、標準品の調達リードタイムでアジア市場向けの装置開発に着手できる

【規格適合の対象範囲】

本製品が担うのは、装置に組み込まれる産業用コンピュータ（部品）としての規格適合です。装置全体としての認証取得は、従来どおり装置メーカーが実施いただく前提となります。

範囲	担当	内容
産業用コンピュータの規格適合	HPC システムズ	基本構成において 6 地域の安全・EMC 規格に適合
拡張カードの調達・組込み	装置メーカー	従来どおり、別ルートでの調達と装置固有仕様へのインテグレーション
装置全体としての認証取得	装置メーカー	従来どおり。内部コンピュータは規格適合済み部材として取り扱い可能

拡張カードの調達および装置固有仕様へのインテグレーションは、従来どおりの進め方となります。本製品の採用により変わるのは、装置に組み込む産業用コンピュータを新規にカスタム開発し個別の認証取得（認証取得を含む）を行う必要がなくなる点です。

※海外安全規格への適合は、標準（基本）構成が対象です。拡張カードを搭載した状態は適合の対象外となります。

【製品概要】

用途に応じて 3 モデルを用意しています。

型番	搭載プロセッサ
IPC-R670EM-SC-REG7	インテル® Core™ i7-14700
IPC-R670EM-SC-REG5	インテル® Core™ i5-14500
IPC-R670EM-SC-REG3	インテル® Core™ i3-14100

【適合規格】

規格	地域	概要
UL	米国/カナダ	製品安全規格に適合
CCC	中国	中国強制製品認証制度に適合
BSMI	台湾	台湾の国家標準規格に適合
KC	韓国	韓国の国家統合認証
CE	欧州	EU 市場で要求される安全規格および EMC 規格に適合
FCC	米国	電磁波干渉に関する技術基準に適合

※うち UL・CCC・BSMI・KC は第三者認証を取得

【主な特長】

- 画像検査に必要な拡張性
PCIe 5.0 x16 スロット×2（CPU 直結）により、フレームグラバードと GPU を帯域を分け合うことなく搭載可能。加えて PCIe 4.0 x4×2、2.5GbE×2 を装備
- 画像検査に必要な演算性能
第 14 世代インテル® Core™、DDR5-5600 により、高解像度画像のリアルタイム処理に対応
- 6 地域の規格適合を基本構成で実現
米国、カナダ、欧州、アジア主要 3 地域（中国・台湾・韓国）を含む
- 長期安定供給と産業グレードの信頼性
インテル® Q670E チップセットによる 2030 年までの長期供給、山洋電気製ファン×4・ニプロン製産業用電源を採用

【主な仕様】

項目	内容
プロセッサ	第 14 世代 インテル® Core™ i7-14700 / i5-14500 / i3-14100
チップセット	インテル® Q670E（2030 年まで長期供給保証）
メモリ	DDR5-5600 nECC U-DIMM／標準 32GB・最大 128GB（4 スロット）
ストレージ	M.2 NVMe（最大 1TB）、2.5" SATA SSD（最大 4TB）、3.5" HDD（最大 20TB）
拡張スロット	PCIe 5.0 x16 ×2（CPU 直結）／ PCIe 4.0 x4 ×2
ネットワーク	2.5GbE ×2 + 1GbE ×1
冷却・電源	山洋電気製ファン ×4／ニプロン製産業用電源（310W 連続・400W ピーク）
OS	Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024（日本語/英語版）
外形寸法・重量	W136 × D360 × H356 mm（突起物除く）／約 9kg

【主な用途】

半導体検査装置／電子部品検査装置／外観検査装置／マシンビジョンによる画像検査装置 等

【価格・供給について】

価格はオープン価格です。詳細な仕様・価格は当社営業窓口までお問い合わせください。発売は 2026 年 8 月 6 日を予定しています。

【今後の展開】

当社にご相談いただく装置メーカーの多くは、国内で開発した装置を海外の生産拠点へ納入されています。その際、装置に組み込むコンピュータの規格適合が、開発期間とコストの負担となってきました。一機種あたりの数量が読みにくい本分野では、装置メーカーが単独で 6 地域分の規格適合に要する費用を負担することは容易ではありません。

こうしたなか当社は、検査対象や装置の構造が異なっても、コンピュータに求められる要件の多くが共通していることに着目しました。一社ごとに個別開発を重ねるのではなく、標準品としてあらかじめ規格適合済みのコンピュータを用意しておくべきと考えました。装置メーカー各社に共通するニーズを標準品に集約し、これまで各社が個別に負担してきた開発・規格適合の費用を、部品メーカーである当社が先行して負担します。

今後も海外規格に事前適合したモデルを拡充し、国内装置メーカーのグローバル展開を支えてまいります。

【HPC システムズ株式会社について】

HPC システムズ株式会社は、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）分野のニッチトップ企業です。

HPC 事業では、科学技術計算用高性能コンピュータとシミュレーションソフトウェア販売、科学技術計算やディープラーニング（深層学習）環境を構築するシステムインテグレーションサービス、シミュレーションソフトウェアプログラムの並列化・高速化サービス、計算化学ソフトウェア、マテリアルズ・インフォマティクスのプログラム開発・販売、受託計算サービス・科学技術研究開発支援、創薬研究開発や素材・材料研究開発分野向けサイエンスクラウドサービスをワンストップで提供しています。また、CTO 事業では、顧客の用途、課題をヒアリングしながら、価格・性能・品質・高低温・防塵・防水・静電対策・過酷な環境に対する高耐久性など多種多様の対応が求められる、工場生産設備・製造装置・検査装置、制御機器や交通インフラ、自動運転、リテール店舗などのコントローラーとしての産業用コンピュータやエッジコンピュータの仕様提案から開発、生産、保守サポート、長期安定供給を実現しています。

社名 HPC システムズ株式会社 <https://www.hpc.co.jp/>

所在地 東京都港区海岸 3 丁目 9 番 15 号 LOOP-X 8 階

設立 2006 年 7 月 3 日

資本金 2 億 3,151 万円（2025 年 12 月 31 日時点）

代表者 代表取締役 小野 鉄平

プレスリリースに関するお問い合わせ

https://www.hpc.co.jp/contact/company_form/